

= US 2004/0233649



⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 101 27 351 A 1**

⑤ Int. Cl. 7:
H 01 L 23/50
B 82 B 1/00

⑳ Aktenzeichen: 101 27 351.7
㉔ Anmeldetag: 6. 6. 2001
㉕ Offenlegungstag: 19. 12. 2002

DE 101 27 351 A 1

⑦ Anmelder:
Infineon Technologies AG, 81669 München, DE
⑦ Vertreter:
Viering, Jentschura & Partner, 80538 München

⑦ Erfinder:
Kreupl, Franz, Dr., 80469 München, DE; Simbürger,
Werner, Dr., 85540 Haar, DE; Hönlein, Wolfgang, Dr.,
82008 Unterhaching, DE; Klose, Helmut, Dr., 81479
München, DE

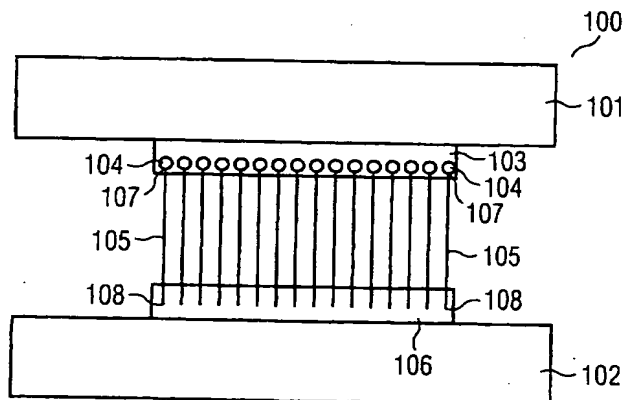
⑤ Entgegenhaltungen:
US 60 20 742
US 58 05 426
EP 10 96 533 A1
EP 10 87 413 A2

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤ Elektronischer Chip und elektronische Chip-Anordnung

⑦ Auf mindestens einem externen Chip-Metallkontakt
des elektronischen Chips ist eine Vielzahl von Nanoröh-
ren aufgebracht zum Kontaktieren des elektronischen
Chips mit einem weiteren elektronischen Chip.



DE 101 27 351 A 1